主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	34	~	54	GHz
插入损耗		0.8		dB
隔离度		20		dB
输入驻波比		1.5		
输出驻波比		1.5		
幅度平衡			0.4	dB
相位平衡			±6	°

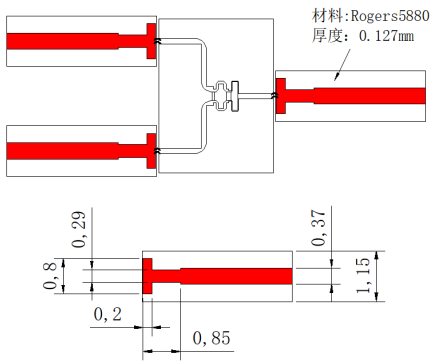
其它参数

功率容量	1W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	微带焊盘
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	陶瓷薄膜工艺

端口定义

公共端口	0
分配端口	1，2

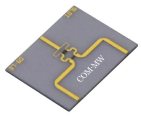
建议PCB布局图



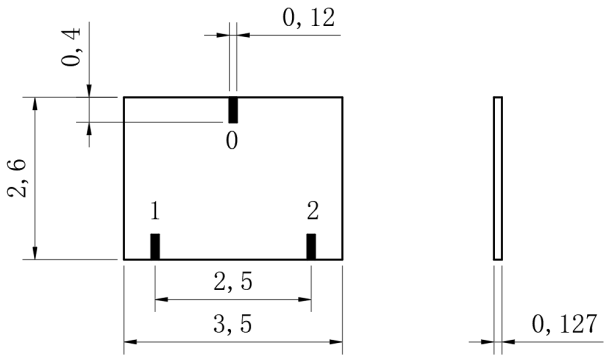
典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB	S23 抑制 dB	S13 相位 °
32.14	1.27	-4.21	-4.09	-17.31	0.56
34.29	1.05	-3.34	-3.39	-19.46	
36.43	1.17	-3.4	-3.22	-21.03	0.39
38.57	1.19	-3.32	-3.22	-23.44	-1.98
40.71	1.42	-3.63	-3.69	-28.12	-2.31
42.86	1.4	-3.48	-3.73	-25.64	-2.67
45	1.45	-3.61	-3.72	-25.57	-1.41
47.14	1.49	-3.63	-3.56	-27.97	-3.45
49.29	1.39	-3.37	-3.52	-26.87	-3.91
51.43	1.27	-3.47	-3.56	-23.45	-4.57
53.57	1.33	-3.36	-3.56	-22.87	-4.41
55.71	1.71	-3.81	-4.02	-30.34	-4.38

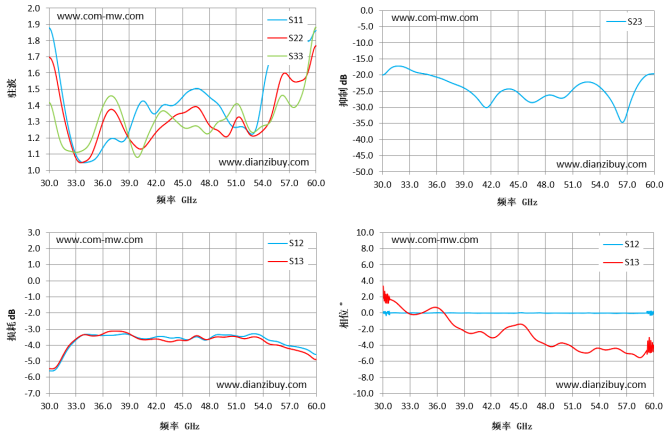
参考实物图



外形结构图（mm）



典型测试曲线图



注意事项

1	芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖1-2mm
2	芯片推荐使用低应力导电胶（ME8456）粘结
3	芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数（6.7ppm/C°）接近的载体，载体厚度≥0.2mm
4	电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。